
「JAPAN PACK 2022」に出展

- ホットメルトサーモ監視システム、調合工程誤投入防止システム、充填ライン管理システムを提案 -

東芝三菱電機産業システム株式会社(以下、TMEIC)(社長:山脇 雅彦)は、2 月 15~18 日に東京ビッグサイトで開催される展示会「JAPAN PACK 2022」に出展します。

TMEIC ブースでは、包材ロスを削減するためのホットメルトサーモ監視システム、誤製品流出を防止するための調合工程誤投入防止システム、品質を確保するための充填ライン稼働管理システムを展示します。

同展示会では、包装業界における最新技術、機器、サービスが集まります。会場にお越しの際には、ぜひ弊社展示ブースにもお立ち寄りください。

1. 展示会名	JAPAN PACK 2022 https://www.japanpack.jp/
2. 場 所	東京ビッグサイト
3. 開催日時	2022年2月15日(火)~2月18日(金) 10:00~17:00
4. 入場費用	事前オンライン登録により無料で入場いただけます。 https://japanpack.eventos.tokyo/web/portal/57/event/3972/module/web_page/102309/0
5. 弊社ブース	西展示棟1F W1-M01
6. 弊社展示製品	<出展システム・機器> ○ ホットメルトサーモ監視システム ○ 調合工程誤投入防止システム ○ 充填ライン稼働管理システム

報道関係からのお問い合わせ先

東芝三菱電機産業システム株式会社 経営企画本部 ブランド企画グループ <https://www.tmeic.co.jp/>
〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン Tel: 03-3277-4319 Fax: 03-3277-4578

TMEIC(ティーマイク)は、社会を支える基盤である「ものづくり」の現場ニーズにお応えするために、社会の発展と美しい地球環境とを調和させる産業システムインテグレータとして、「産業」「社会」「環境」の未来を常に見据えています。工場・プラントにおいて原動力となっている回転機、電力を変換・制御するパワーエレクトロニクス、そしてプラント全体を計画し実現するエンジニアリング、これらの技術をコアに、ものづくりと環境マネジメントに最先端の技術で貢献していきます。